



日本シイエムケイ株式会社
(証券コード：6958)

中期経営計画の見直し

(2025年3月期～2027年3月期)

2023年11月9日

日本シイエムケイ株式会社

1. 振り返り・長期ビジョン2030

2. 中期経営計画の見直し（2025年3月期～2027年3月期）

- －更新理由・サマリー・数値目標の上方修正

- －車載成長戦略

- －収益基盤の強化

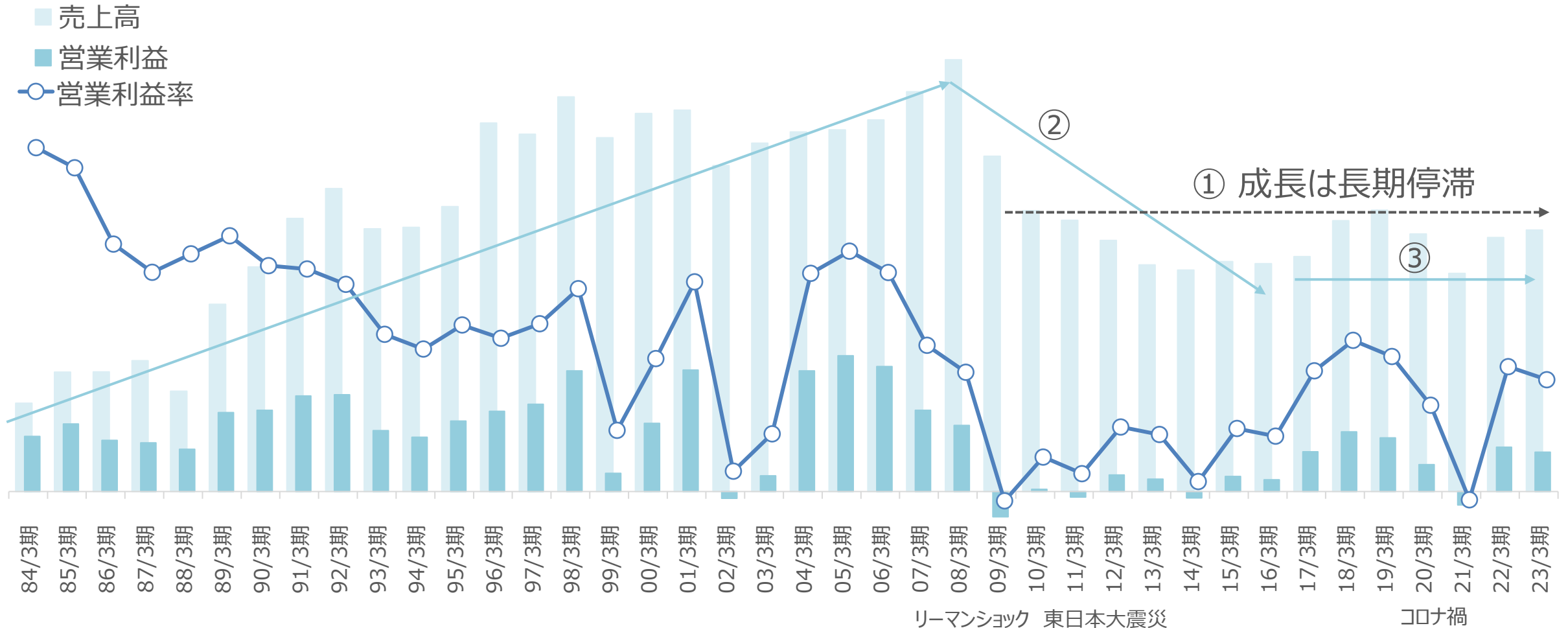
- －財務戦略・経営基盤の強化

3. 補足資料

当社ヒストリー



- ① 2008年3月期の過去最高売上高以降、成長は長期停滞。
- ② 2016年3月期まで生産拠点統廃合により生産キャパシティを縮小。
- ③ 2017年3月期以降、安定した収益基盤への再構築。

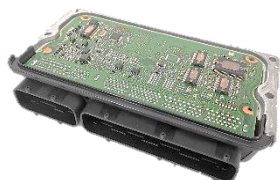


これまで成し遂げてきた価値創造

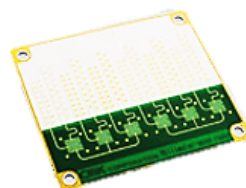
社会的課題を捉え、必要とされるソリューションを提供し、社会の価値創造に貢献してきた

⇒常に新たな社会・価値観に適応した『世界最高レベルの安全安心なプリント配線板』を供給し続けることにより、安全で快適な社会を実現することが当社の存在意義

エンジンECU向けPCB
(世界最小の“手のひらECU”)



ADAS (アンテナ一体型) 向けPCB
高精細回路による小型・高精度化



ドメイン型～ゾーン型へ
アーキテクチャ変換に伴う
高機能統合ECU向けPCB

当社の歩み

2008年

2010年

2022年

2023年

これから目指す未来/2030年



世界初のHEV向け
回生協調ブレーキ向けPCB

世界初の量産BEV向け
インバーター/コンバーター/電池制御PCB

新事業領域向けPCB
(eVTOL、航空・宇宙分野向けなど)

2030年に向けて（ありたい姿）

モビリティと社会インフラの融合による新しい社会での価値創出と、
人々が安全に、快適に過ごせる社会の実現に貢献する

CMK Vision2030

- ・『世界最高レベルの安全安心なプリント配線板』
を提供し続けることにより、安全で快適な社会づくりに貢献する
- ・コンプライアンスを遵守し、経営の健全性と透明性を高める

2030年に向けて（中期経営計画の位置づけ）

『成長加速ステージ』の次の新たな成長軌道にのることにより、
2030年に向けて企業価値の最大化を目指す

2030年
新たな成長軌道

売上高 : 1,500億円
営業利益率 : 10%

企業価値の
最大化

26/3期～27/3期

成長加速ステージ

・CASE需要の取込みによる
成長サイクルの確立

23/3期～25/3期

収益基盤の確立・
成長への仕込み

成長分野の集中投資により、
PCB市場予測を上回る成長

- ・事業構造改革による生産効率化
- ・車載製品ポートフォリオの高付加価値シフト

1. 振り返り・長期ビジョン2030
2. 中期経営計画の見直し（2025年3月期～2027年3月期）
 - －更新理由・サマリー・数値目標の上方修正
 - －車載成長戦略
 - －収益基盤の強化
 - －財務戦略・経営基盤の強化
3. 補足資料

見直し理由（前中計からの変化点）

- 1. 主要顧客の中長期需要が非常に強い（上振れ）**
電動化の進展や、自動運転向けのアイテムが具体的に立ち上がるなど、中長期需要が大きく上振れ
- 2. 新規顧客からの引き合いが旺盛**
サプライチェーンの地政学リスク回避の流れもあり、現在、建設中のタイ新工場に対する顧客ニーズ（特に外資顧客）が更に高まる

サマリー：

1. 車載成長戦略

- ・CASE需要取込みによる売上成長
- ・外資顧客比率アップ
- ・高付加価値シフト

2. 収益基盤の強化

- ・事業構造改革による固定費削減
- ・大判化、自動化投資による生産性向上
- ・新事業領域の確立

3. 財務戦略・ 経営基盤の強化

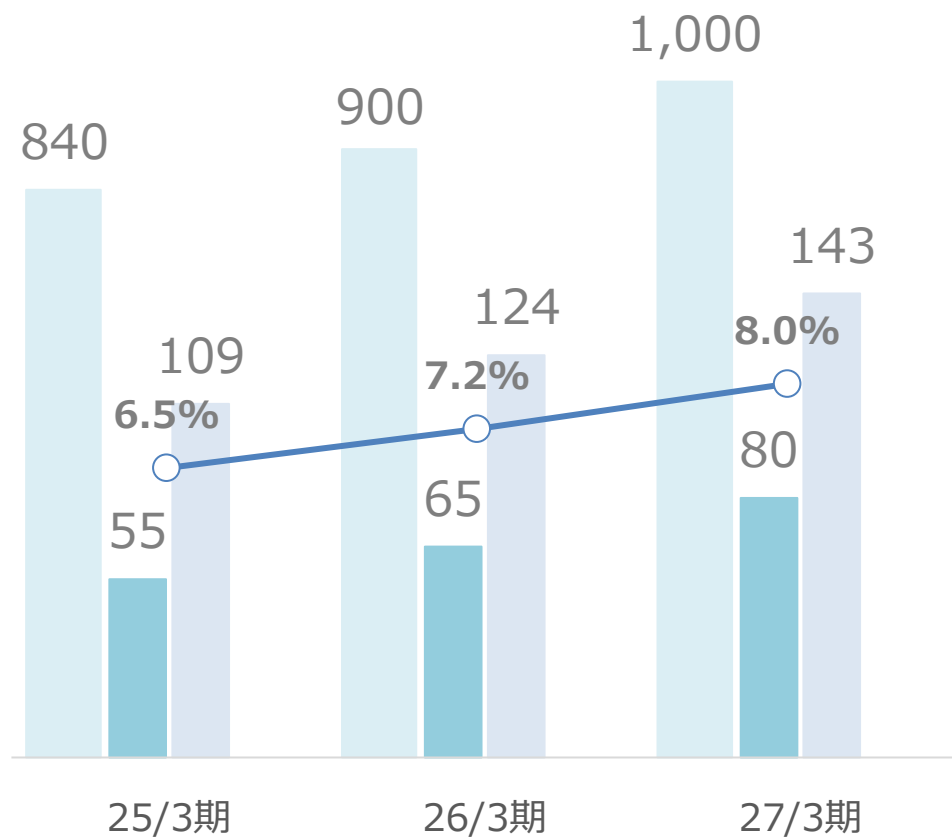
- ・キャピタルアロケーション
- ・デジタル経営基盤の構築、サステナビリティ活動の強化
- ・企業価値向上（PBR向上に向けて）

数値目標の上方修正

<2021年11月策定 中期経営計画>

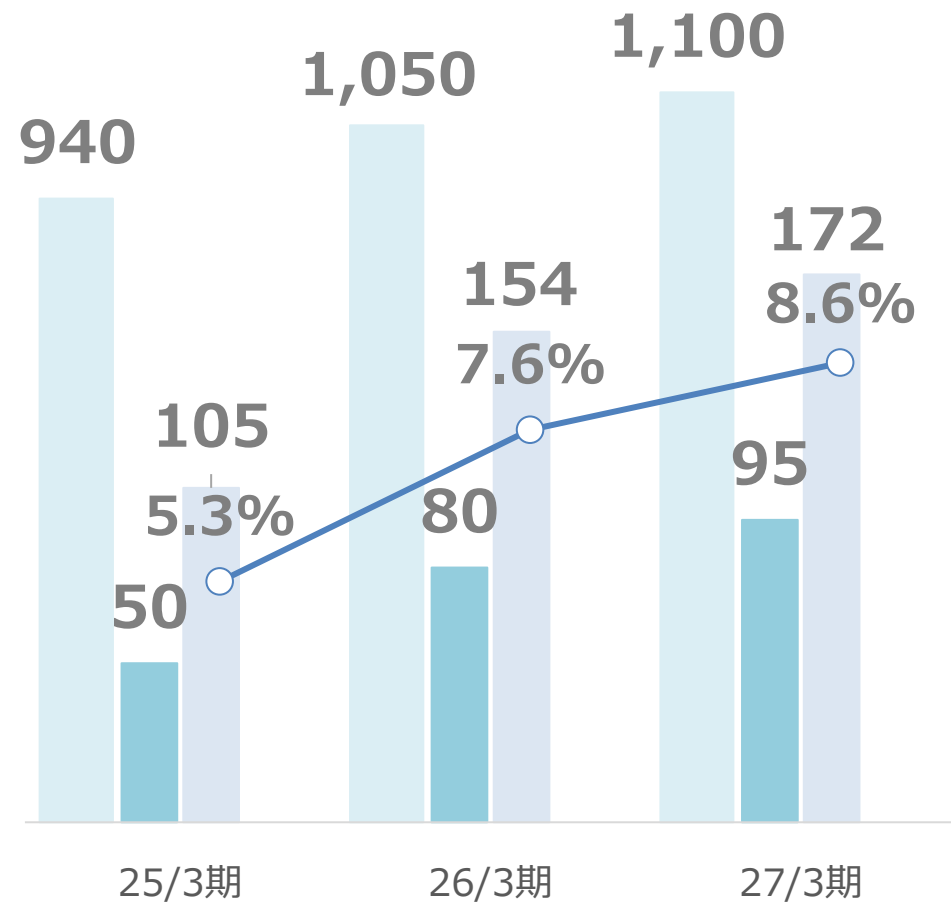
■ 売上高 ■ 営業利益 ■ EBITDA ○ 営業利益率

(単位：億円)



<2023年11月見直し 中期経営計画>

■ 売上高 ■ 営業利益 ■ EBITDA ○ 営業利益率



1. 振り返り・長期ビジョン2030

2. 中期経営計画の見直し（2025年3月期～2027年3月期）

－更新理由・サマリー・数値目標の上方修正

－**車載成長戦略**

－収益基盤の強化

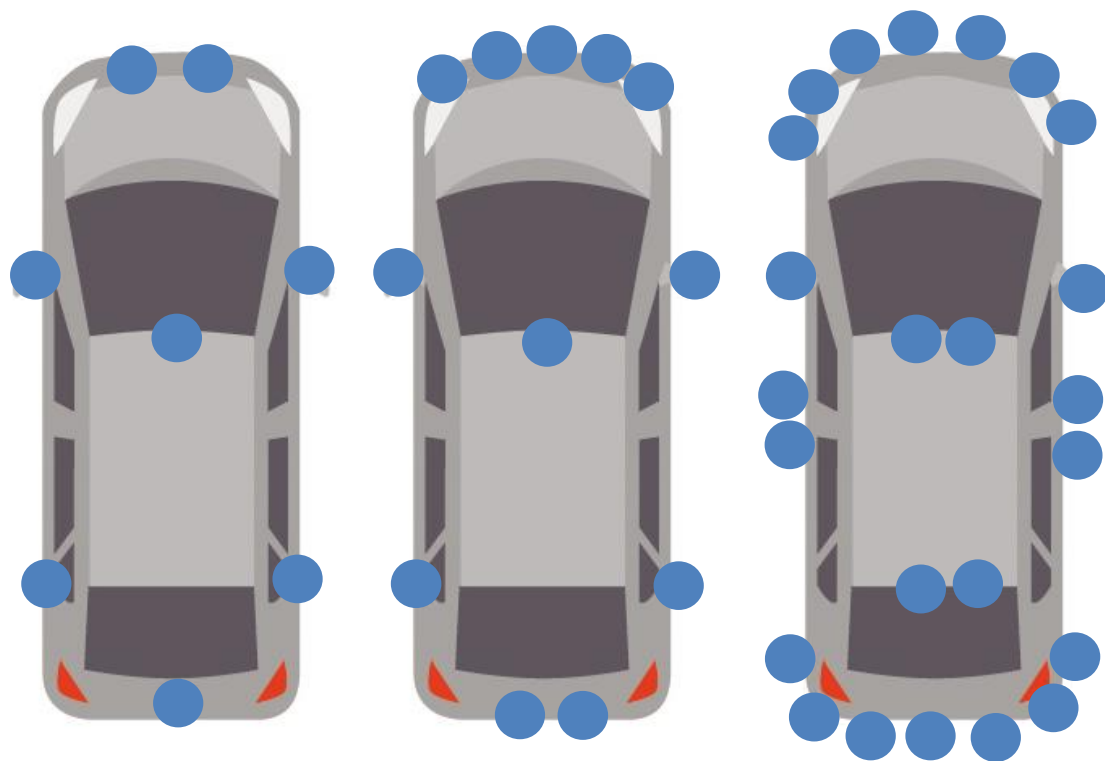
－財務戦略・経営基盤の強化

3. 補足資料

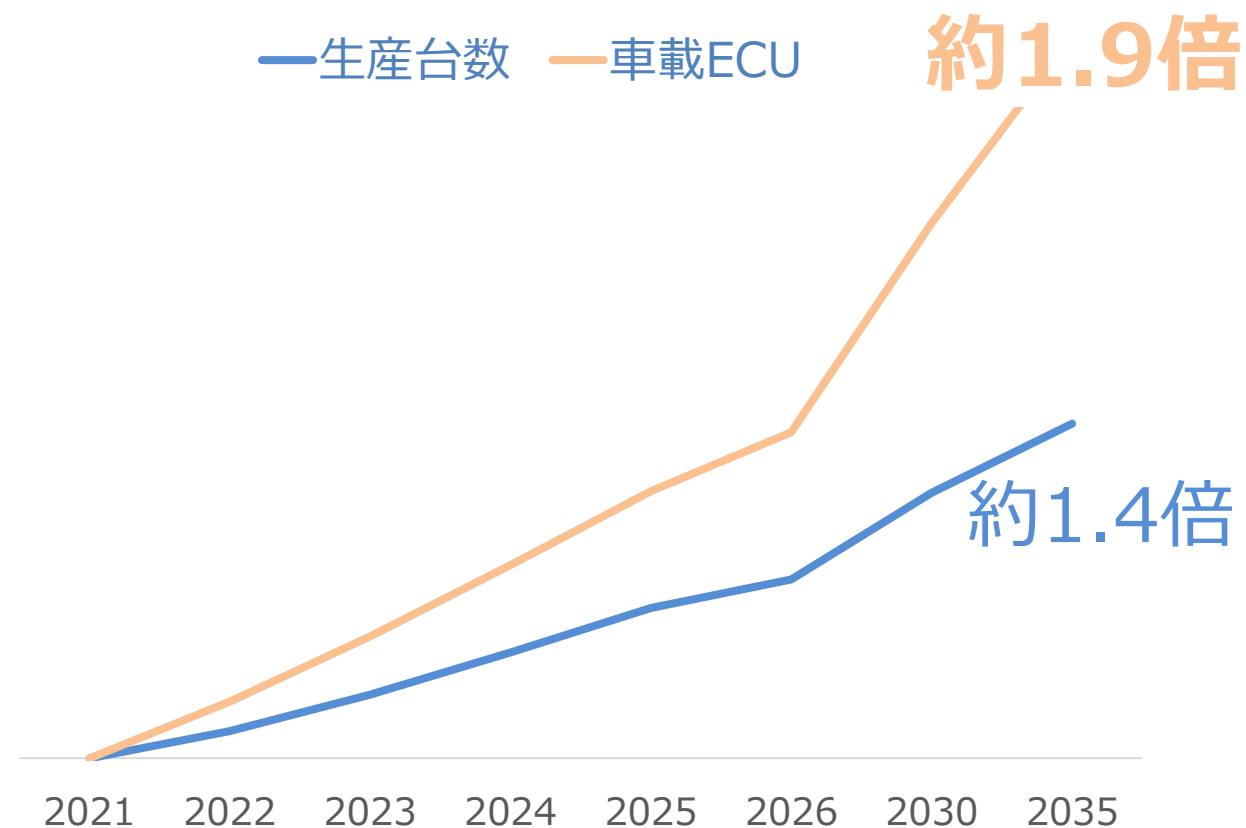
車載成長戦略（今後の潮流①）

自動運転機能などの制御複雑化により、 ECUの搭載数は自動車生産台数を超えるペースで増加

＜自動運転レベル及びセンサー、カメラなどの数量イメージ＞
（当社推定）



＜自動車生産台数・車載ECU指数推移＞

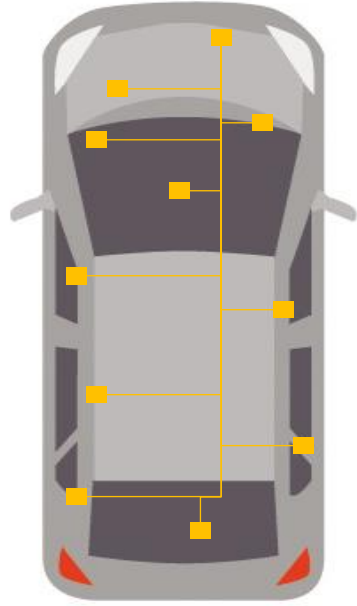


* 2022年は見込、2023年以降予測

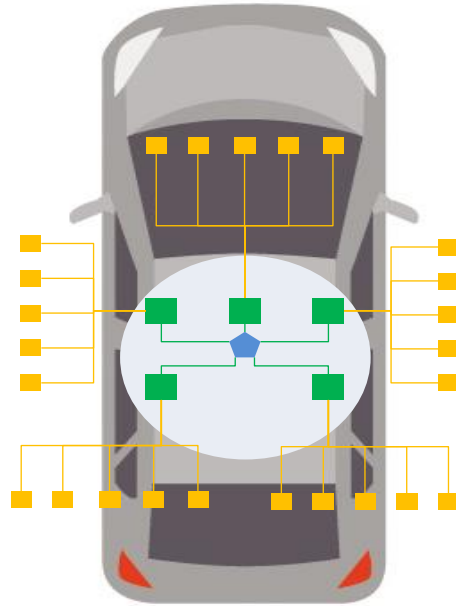
* 出所「車載電装デバイス&コンポーネンツ総調査 2023 下巻」富士キメラ総研

車載成長戦略（今後の潮流②）

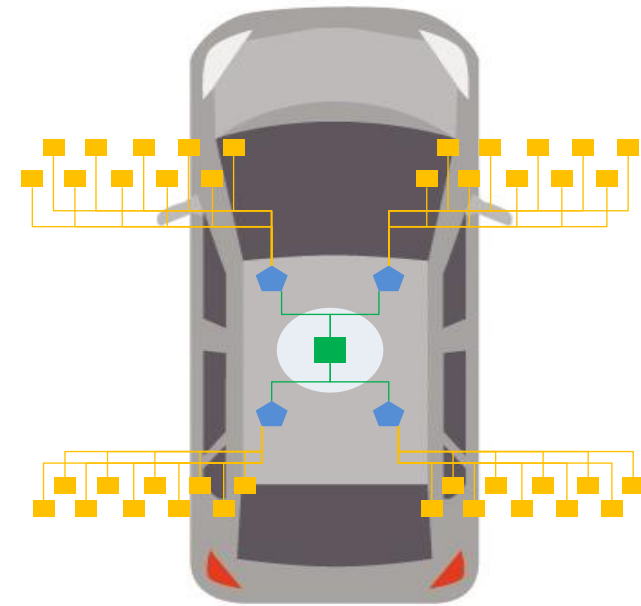
分散型アーキテクチャ



ドメイン型アーキテクチャ



ゾーン型アーキテクチャ



- 個別ECU
- 統合ECU
- ◆ ゲートウェイ

現状

2025年

2030年

ECUの高機能化が進み、プリント配線板に対しては、様々な要素技術が必要とされる
『製造技術の上位互換性』
⇒ビルドアップ配線板のニーズが拡大

車載成長戦略（事業機会とターゲットアイテム）

用途	パワートレイン系	走行安全系
<p>当社の強みと実績</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・車載要求を理解したモノづくりと品質マネジメント ・解析能力、顧客対応スピード ・安定した財務基盤に基づく、長期の製品供給、保証体制 ・日本、中国、東南アジアの3拠点において同一製品、供給可能 	<ul style="list-style-type: none"> ・車載向けビルドアップ基板に対応しうる技術力、供給体制 ・日系、欧州Tier1メーカーとの技術開発～量産立上げ
<p>事業機会</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・CASE進展に伴い、プリント配線板の使用量は大幅に増加 ・ECUの統合化などによる高機能化（ビルドアップ配線板のニーズ拡大） 	
<p>ターゲットアイテム</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・駆動系 統合ECU ・BEV/HEV系ECU ・インバーター、DC-DCコンバーター ・駆動用二次電池（バッテリー） ・パワーコントロールユニット（PCU）など 	<ul style="list-style-type: none"> ・ADAS 統合ECU ・画像センサー、カメラモジュール ・ミリ波レーダー、LiDAR ・ドライバーサポートシステムなど

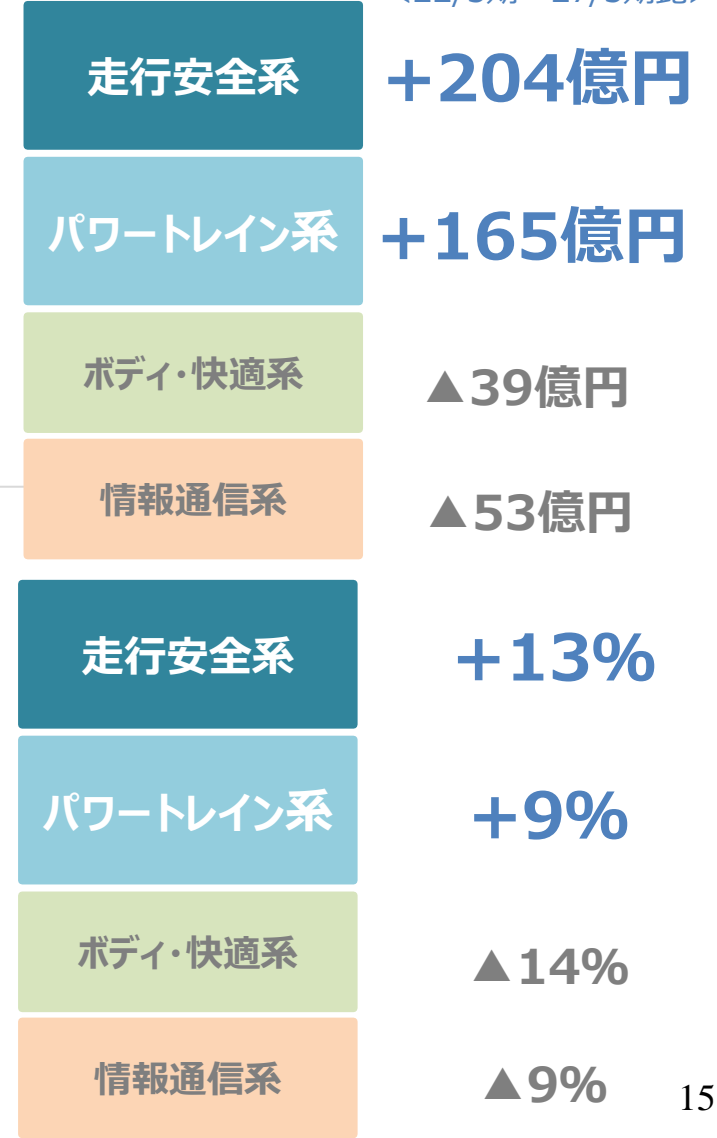
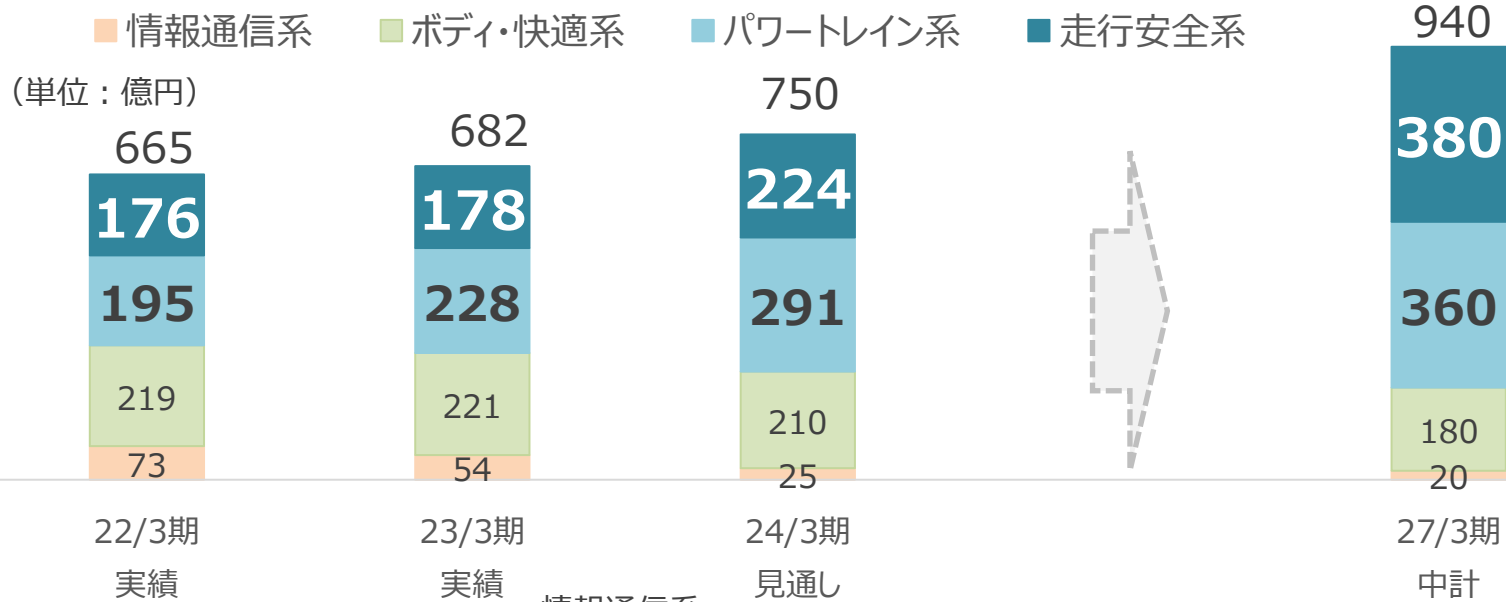
車載成長戦略（用途別売上）



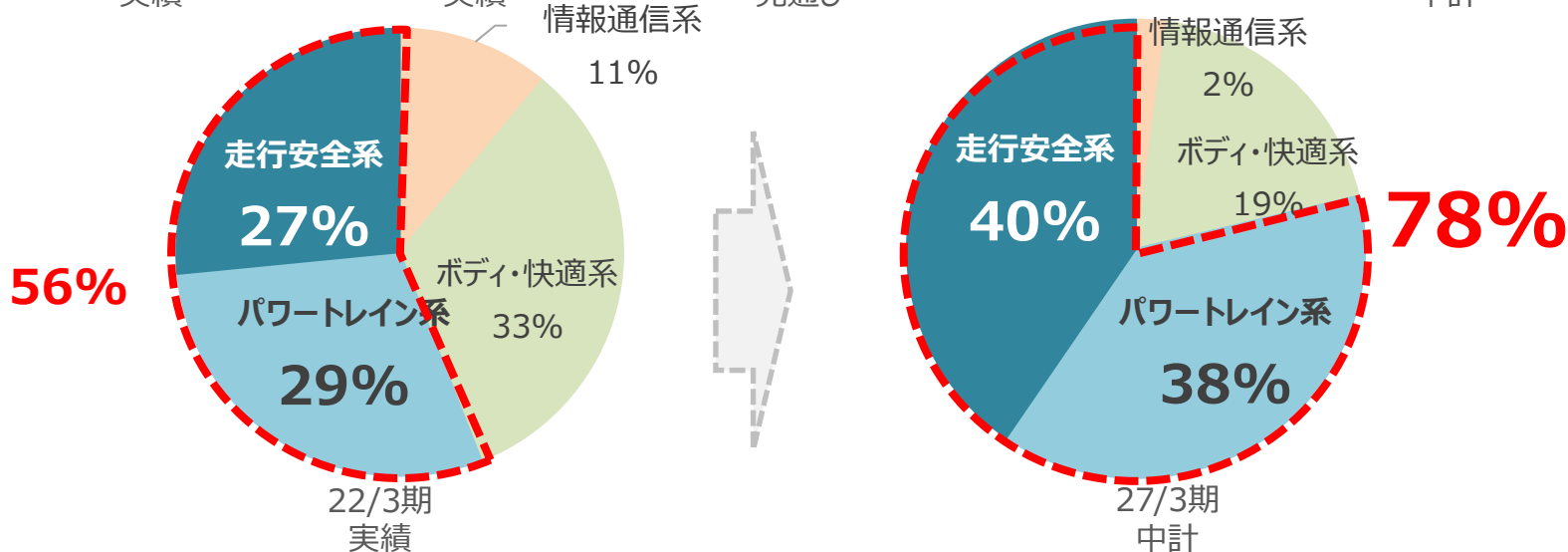
当社の競争優位性のある車載製品ポートフォリオへ大きくシフト

<22/3期-27/3期比>

用途別売上

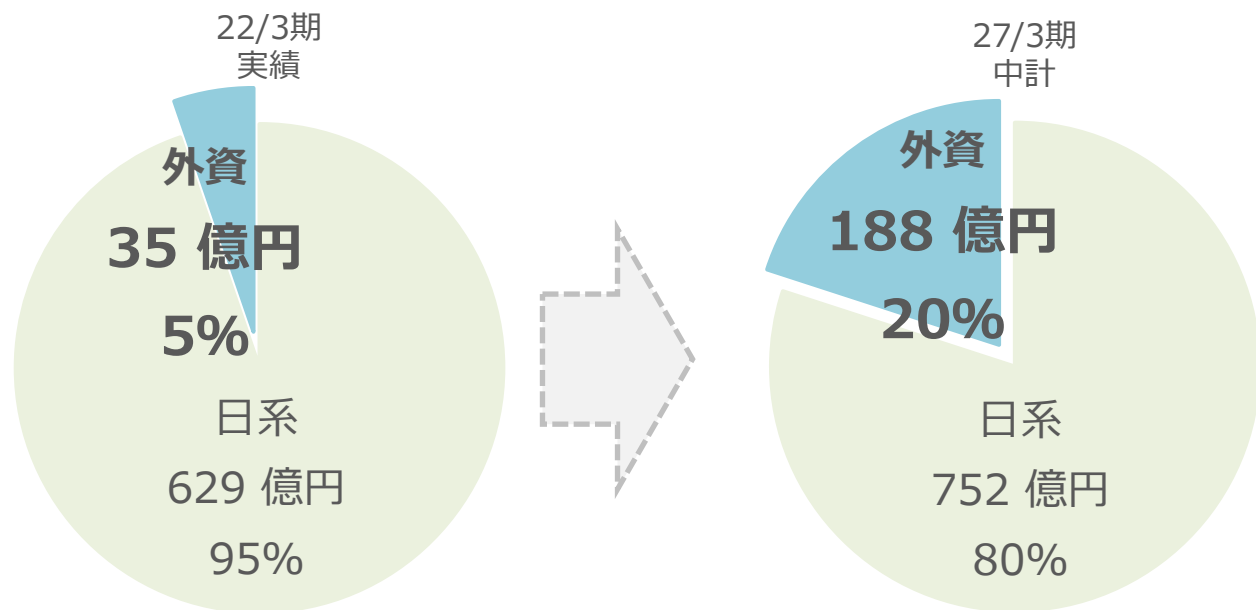


用途別売上構成比



車載成長戦略（顧客別・基板種別売上）

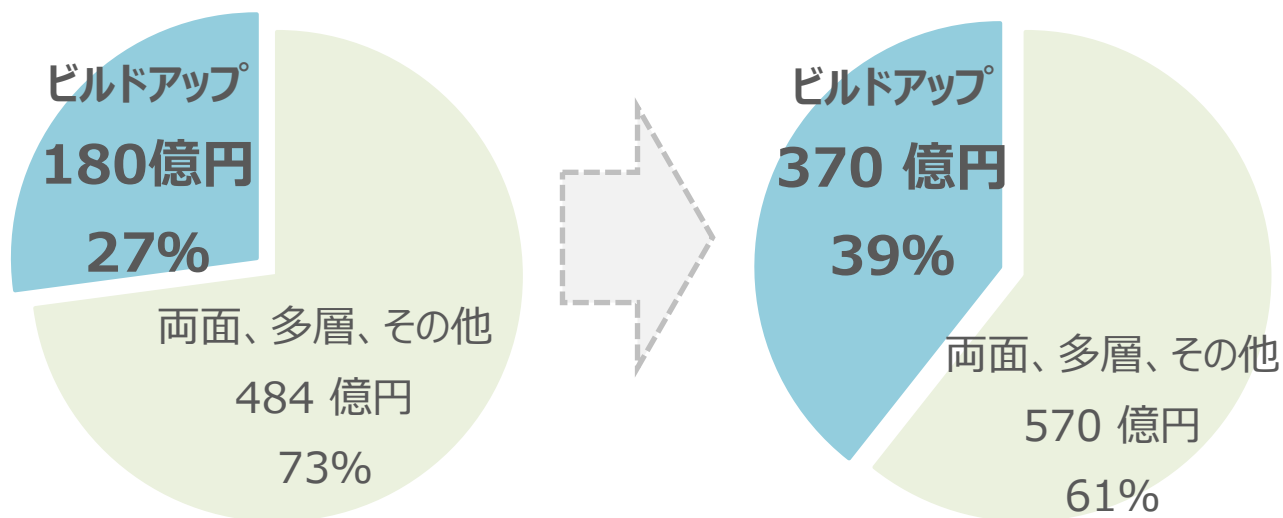
顧客別売上（構成比）



顧客ポートフォリオの多様化
（外資比率アップ）

外資顧客向け：
売上高 **+153億円**
売上構成比 **+15%**

基板種別売上（構成比）



高付加価値シフト
（ビルドアップ比率アップ）

ビルドアップ配線板：
売上高 **+190億円**
売上構成比 **+12%**

参考：PCB市場予測

当社の中期経営計画は市場予測を上回る成長

<車載向けプリント配線板市場予測vs当社車載向け中計>

<プリント配線板市場予測vs当社中計>

【車載向けPCB市場予測】

21年vs27年

CAGR 約5.4%

【PCB市場予測】

21年vs27年

CAGR 約1.9%

【当社車載向け中計】

21年vs27年

CAGR 約8.8%

（内：パワートレイン走行安全系：約16.5%）

【当社中計】

21年vs27年

CAGR 約7.8%

車載成長戦略（2030年に向けた成長ポテンシャル）



タイ工場に対する中長期需要（顧客からの引き合い）は、27年3月期の車載向け売上計画に対して約120%と非常に強い

＜タイ新工場の投資余力＞



＜タイ工場のキャパシティ＞

	現状	新工場 第1期投資後	新工場 第2期投資
スケジュール	—	2024年	検討中
投資金額	—	約250億円	
生産能力/月産 (現状+新工場)	13万㎡	16万㎡	20万㎡
内 両面・多層	11.3万㎡	12.6万㎡	13.2万㎡
内 ビルドアップ ^o	1.7万㎡	3.4万㎡	6.8万㎡

1. 振り返り・長期ビジョン2030

2. 中期経営計画の見直し（2025年3月期～2027年3月期）

- －更新理由・サマリー・数値目標の上方修正

- －車載成長戦略

- －**収益基盤の強化**

- －財務戦略・経営基盤の強化

3. 補足資料

収益基盤の強化（日本セグメント）

日本セグメント

■ 収益基盤構築の為の改善施策（今まで）

- ・内製化推進による限界利益率向上
- ・生産拠点の集約、再編によるコスト削減・効率化
(2023年9月末完了)

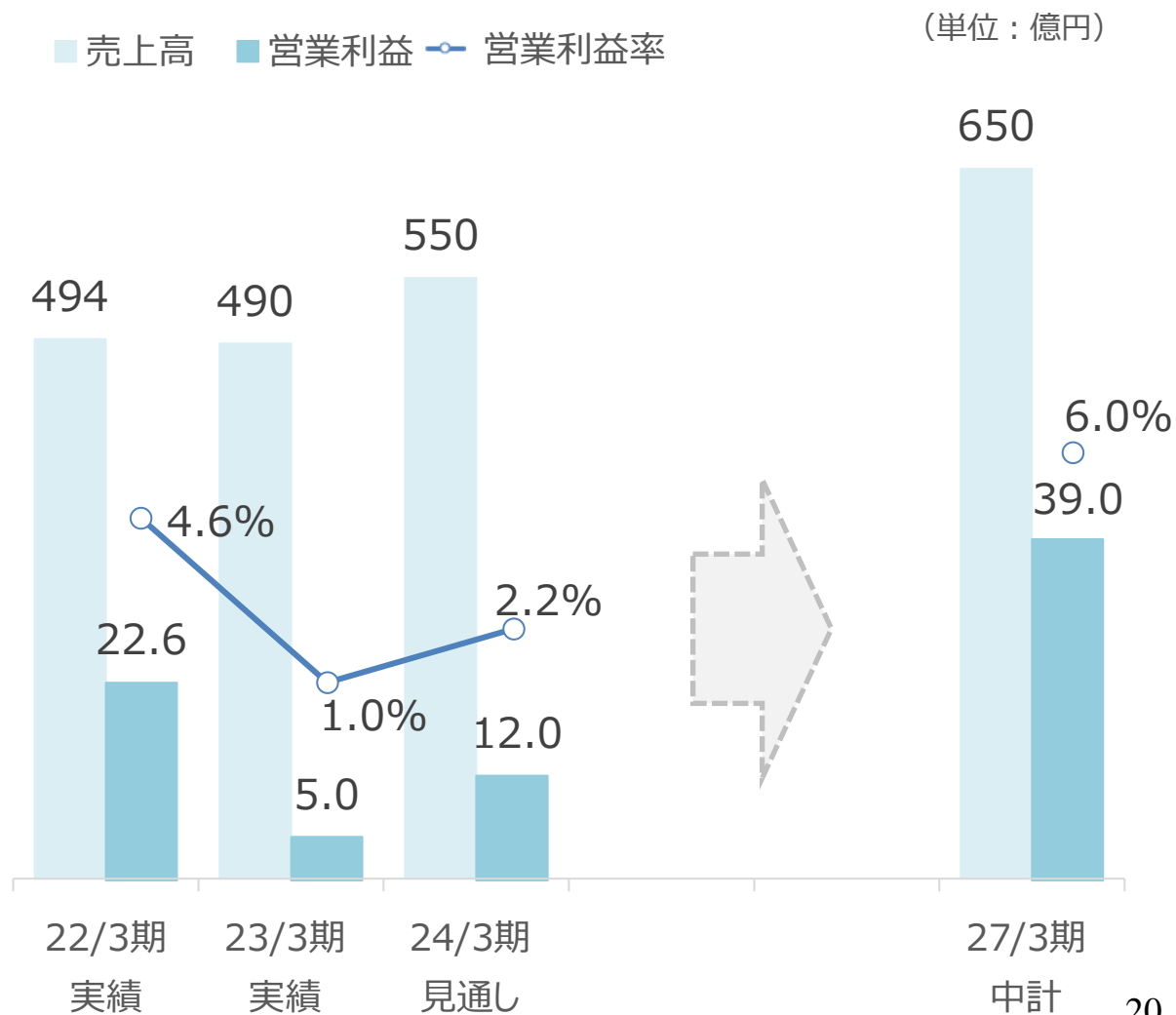
■ 今後の課題

- ・既存生産体制における利益最大化

■ 今後の取り組み

- ・高付加価値シフト投資／ビルドアップ生産比率向上
(ターゲットアイテム 自動運转向け統合ECU等)
- ・新事業領域の確立による利益創出
- ・サプライチェーンの強靱化
(タイ、中国、日本3拠点供給体制維持)

売上高・営業利益・営業利益率



新事業領域成長戦略

必要とされる技術	成長期待市場	重要テーマ
<ul style="list-style-type: none"> ・高アスペクト ・多段ビルドアップ ・細線 ・高密度化 ・高周波材 ・厚銅 など 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 次世代空モビリティ  	<ul style="list-style-type: none"> ・エアモビリティ市場への参入 ・eVTOL（電動垂直離着陸機）向け基板を供試
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 航空・宇宙  	<ul style="list-style-type: none"> ・JAXA宇宙部品認定（2023年8月24日） ・JAXAの宇宙事業貢献 ・民間宇宙開発へ参入 フライトモデルの基板を供試
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 半導体関連  	<p>技術開発した高アスペクトTHの技術で、半導体用検査治具を中心に、売上拡大</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 産業機器・ロボティクス  	<p>高周波材料、ビルドアップ基板、RF基板、放熱基板などの多彩な商品ラインナップによる様々なVCOへの対応。AW～基板製造～実装までのワンストップサービスで受注拡大</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 通信  	<p>技術開発した高周波材料とビルドアップ基板を中心に、beyond5Gモデルへ参入</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 医療  	<p>車載で培った高い品質による安定性を武器に、受注拡大</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 電力・インフラ  	<p>高電流、高電圧技術を活用した、受注拡大</p>

収益基盤の強化（中国セグメント）

中国セグメント

■ 収益基盤構築の為の改善施策（今まで）

- ・100%内製化による限界利益率向上
- ・自動化投資による歩留り・生産性向上

■ 今後の課題

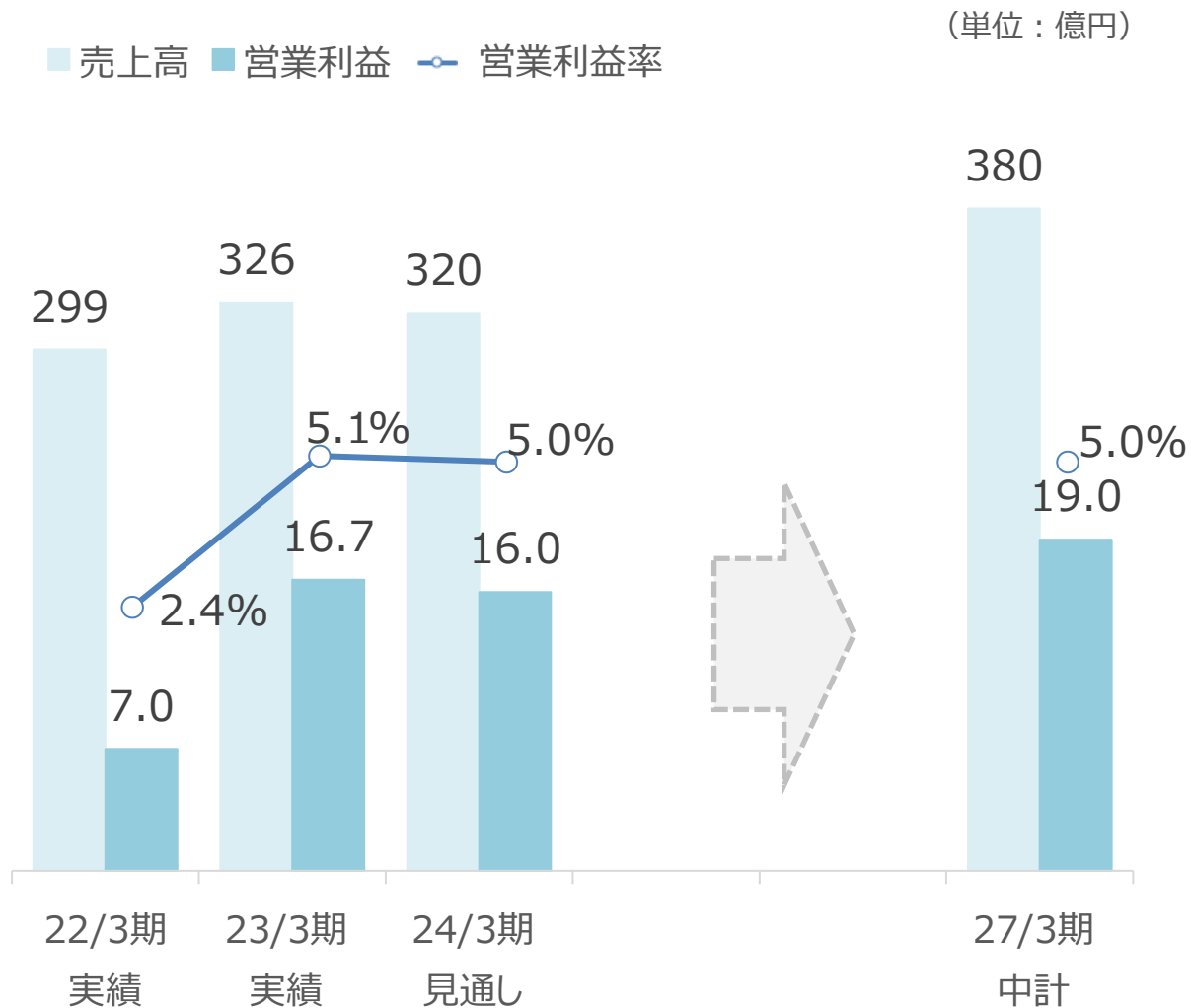
- ・中国市場におけるリスク対応
- ・既存生産体制における競争力強化

■ 今後の取り組み

- ・汎用車載プリント配線板のファブライト化推進
- ・大判化投資による更なる生産性向上

* ファブライト化：製造を外部委託すること（OEM）

売上高・営業利益・営業利益率



収益基盤の強化（東南アジアセグメント）

東南アジアセグメント

■ 収益基盤構築の為の改善施策（今まで）

- ・歩留まり改善による生産性向上
- ・外資顧客への拡販

■ 今後の課題

- ・外資顧客への更なる拡販
- ・新工場第2期投資の早期意思決定

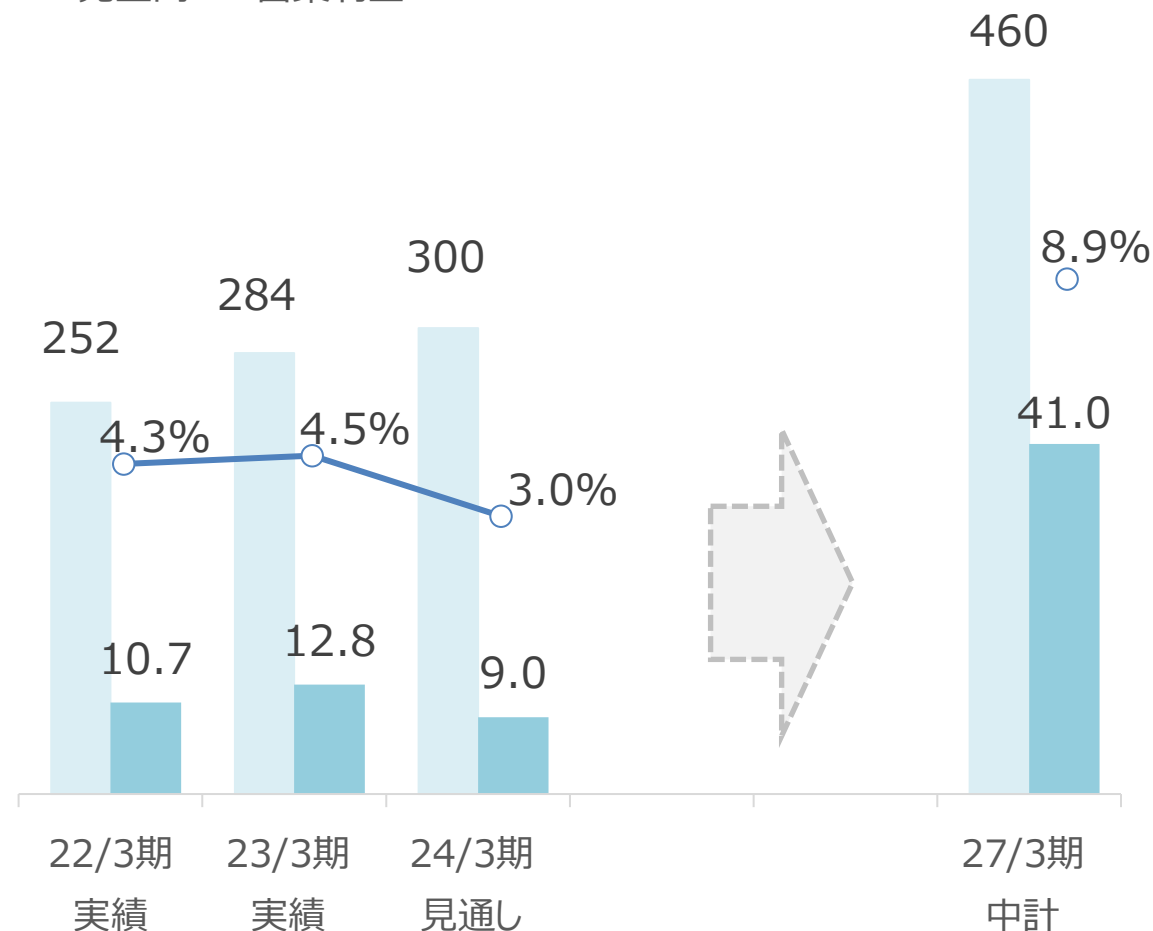
■ 今後の取り組み

- ・自動化、大判化、フィルムレスによる生産性向上
- ・第2期投資内容の具現化

売上高・営業利益・営業利益率

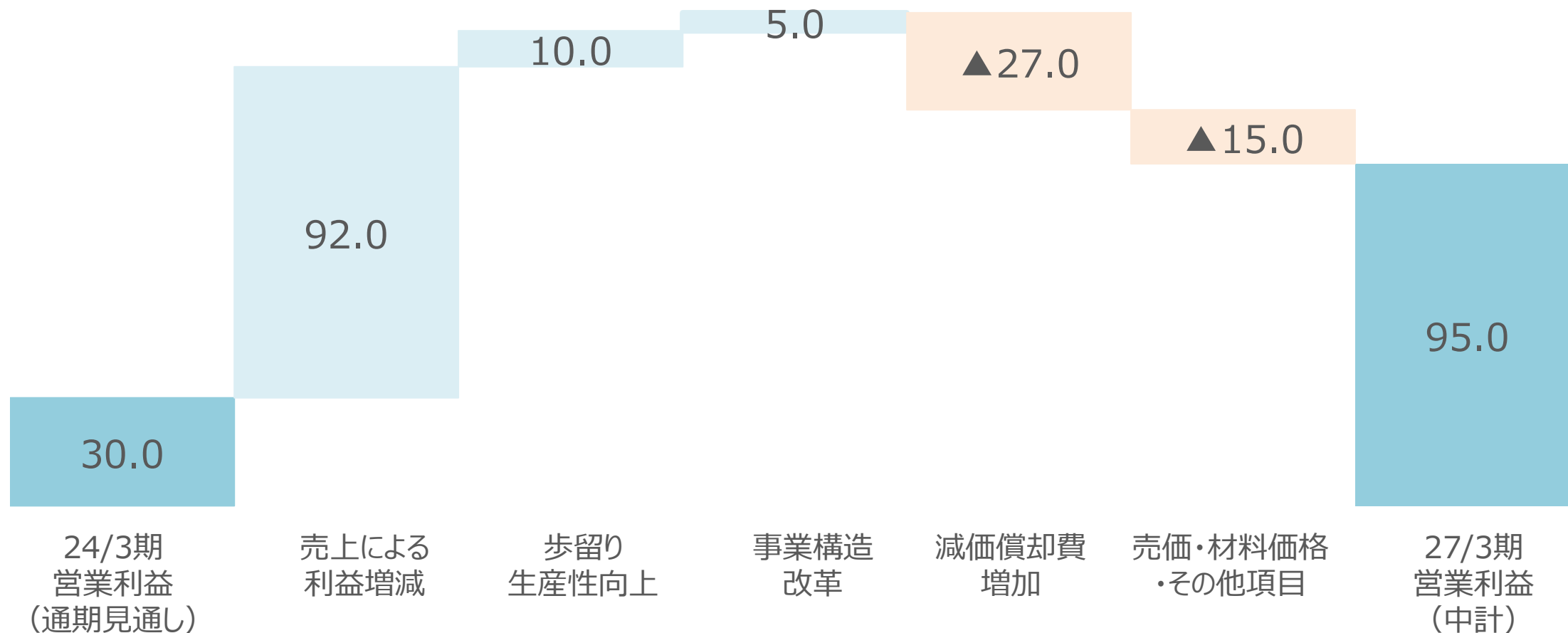
■ 売上高 ■ 営業利益 ○ 営業利益率

(単位：億円)



収益基盤の強化（営業利益増減分析）

（単位：億円）



1. 振り返り・長期ビジョン2030

2. 中期経営計画の見直し（2025年3月期～2027年3月期）

- －更新理由・サマリー・数値目標の上方修正

- －車載成長戦略

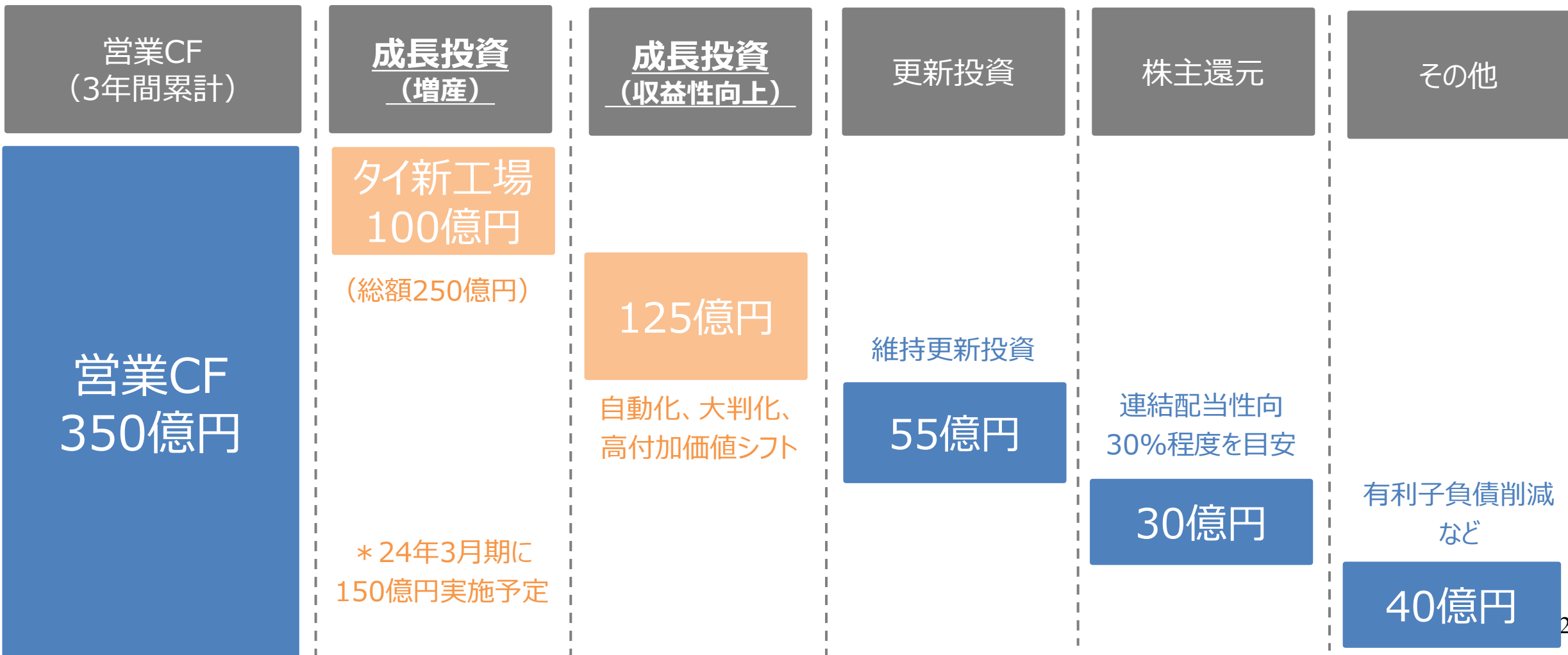
- －収益基盤の強化

- －財務戦略・経営基盤の強化

3. 補足資料

財務戦略（キャピタルアロケーション）

中長期的な財務健全性を維持しつつ、
CASE需要の取り込みに向けた成長投資を継続し、着実にキャッシュを創出する



経営基盤の強化（デジタル経営基盤による成長）

デジタルを活用して、経営基盤の更なる強化を実現し、生産性向上と、業務効率化を図る（スピード・可視化の向上）



■ デジタル技術を活用したモノづくりの高度化
モノづくりの知見を共有化、およびAIの活用による生産性、品質維持向上

■ 基幹システムの再構築による
管理・間接業務の削減・効率化

経営基盤の強化（サステナビリティ活動の強化）

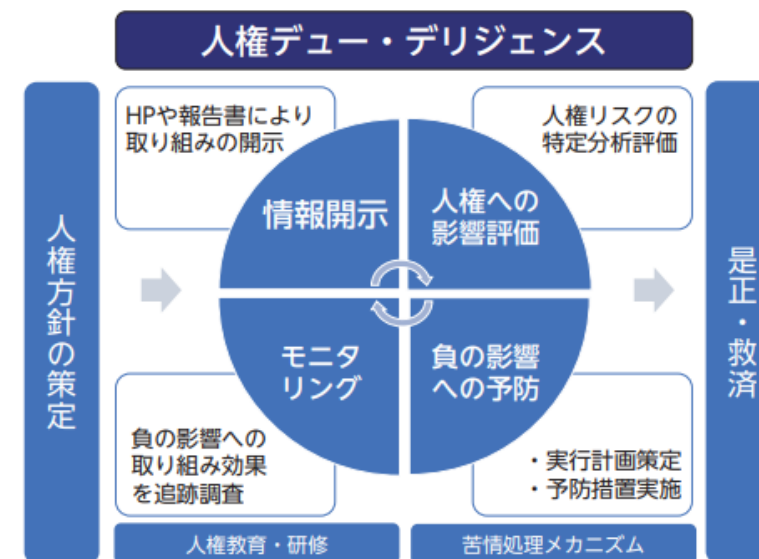
＜カーボンニュートラルへの取り組み＞

当社は、“Smart e-changes NetZero” を掲げ、カーボンニュートラルを目指し、推進してまいります。



＜人権デュー・ディリジェンスへの取り組み＞

現在、人権デュー・ディリジェンスの取り組みを進めています。具体的には、人権への影響評価の特定に向け、深刻度と発生可能性の観点から当社の事業活動に関連して発生しうる人権侵害のリスクマップの作成、負の影響の予防としてサプライチェーンの管理、また、社内外からの人権侵害相談窓口の設置など様々な取り組みを進めています。

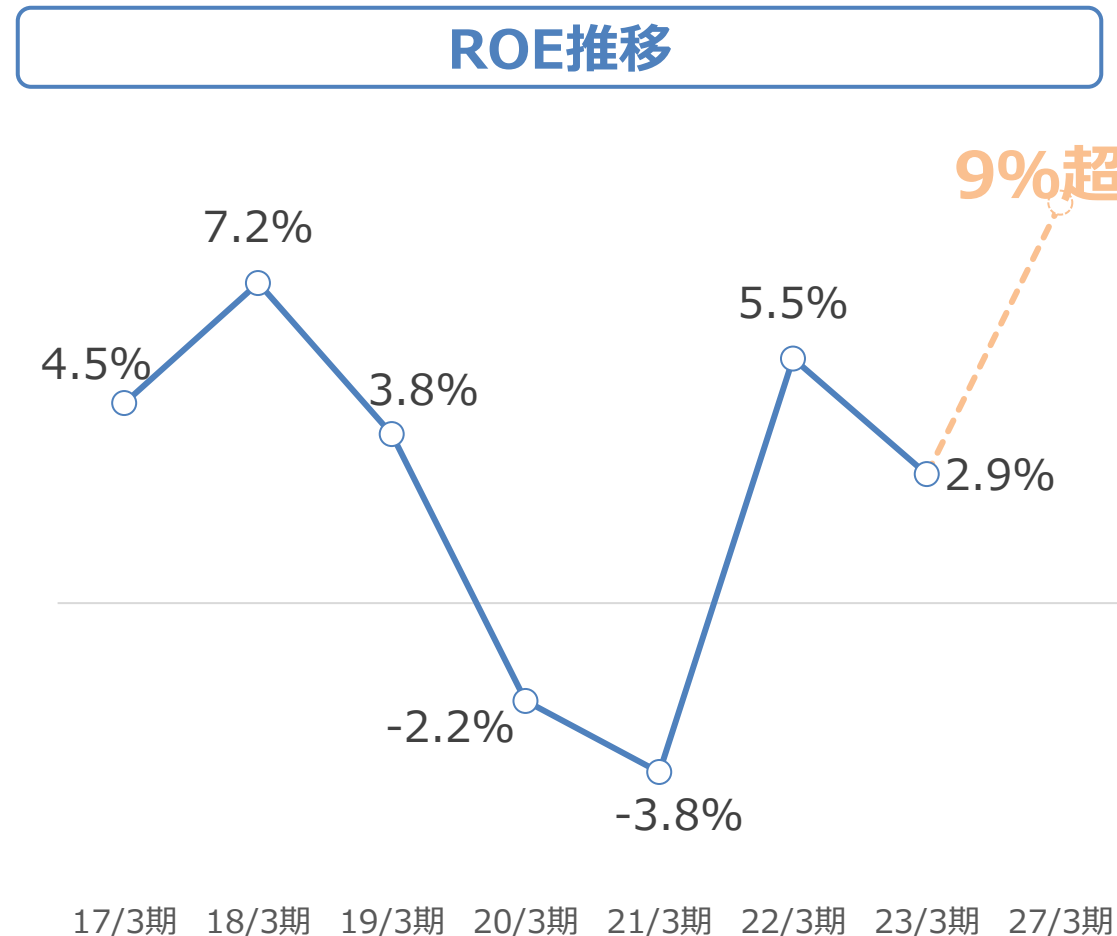
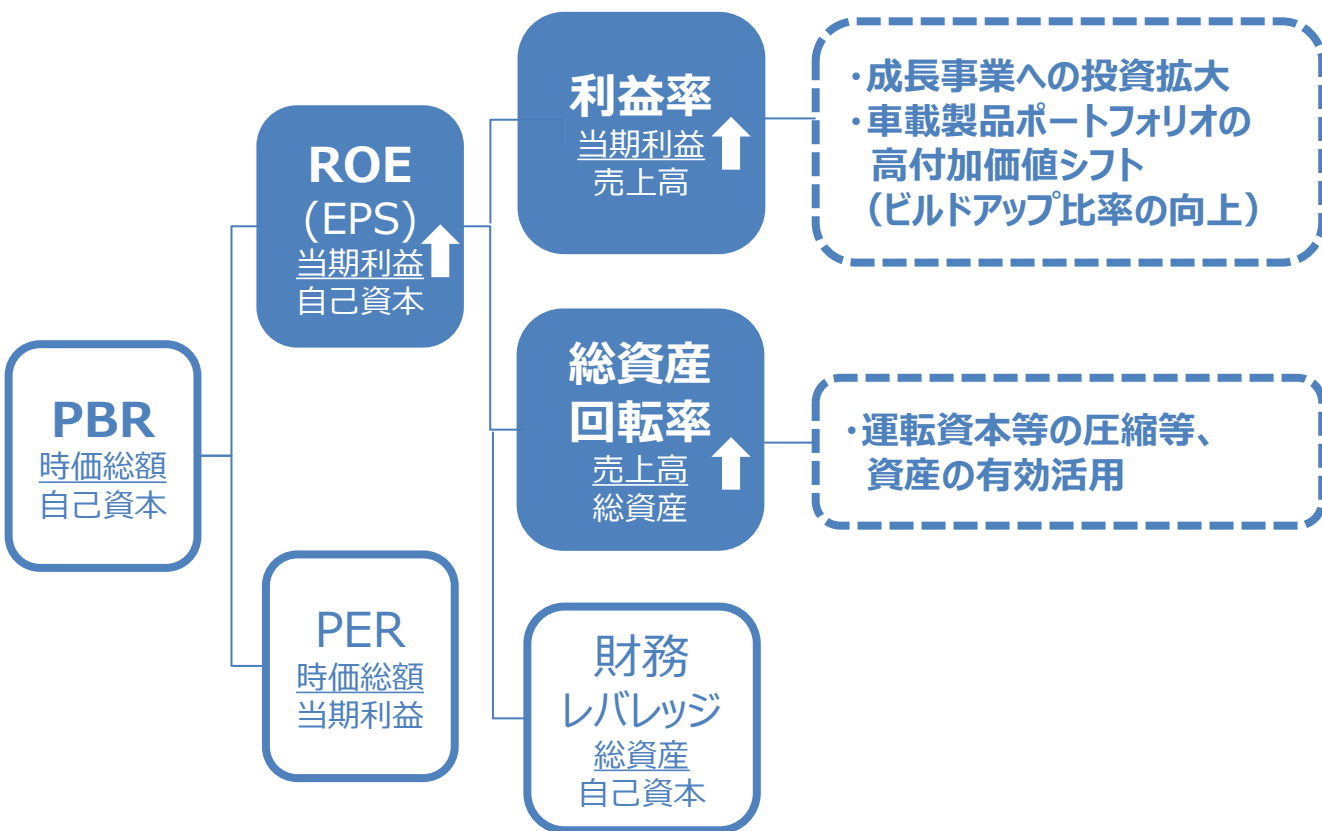


* 詳細は下記URLをご覧ください。

<https://www.cmk-corp.com/csr/doc/CMKReport2023.pdf>

企業価値向上（PBR向上に向けて）

現状認識：株価はPBR1倍を下回る状況が継続。資本コストを下回る収益性及び低い成長期待が課題
 ⇒企業価値向上に向けて、資本コストを意識した経営に取り組む



数値目標（2027年3月期）



売上高

1,100億円

営業利益

95億円

営業利益率

8.6%

ROE

9%超

自己資本比率

50%前後

1. 振り返り・長期ビジョン2030

2. 中期経営計画の見直し（2025年3月期～2027年3月期）

- －更新理由・サマリー・数値目標の上方修正
- －車載成長戦略
- －収益基盤の強化
- －財務戦略・経営基盤の強化

3. 補足資料

① 連結損益

(億円)	25/3期 中計	26/3期 中計	27/3期 中計
売上高	940	1,050	1,100
営業利益	50	80	95
率	5.3%	7.6%	8.6%
EBITDA	105	154	172

* 前提為替レート (USD/JPY) 130.00

②用途別売上高

(億円)	22/3期 実績	27/3期 中計	増減額	増減率
車載	665	940	+274	+41%
パワートレイン系	195	360	+165	+84%
走行安全系	176	380	+204	+115%
ボディ・快適系	219	180	-39	-18%
情報通信系	73	20	-53	-73%
通信	9	15	+5	+60%
新事業領域	-	70	+70	-
その他	140	75	-65	-47%
合計	814	1,100	+285	+35%

③基板種別売上高

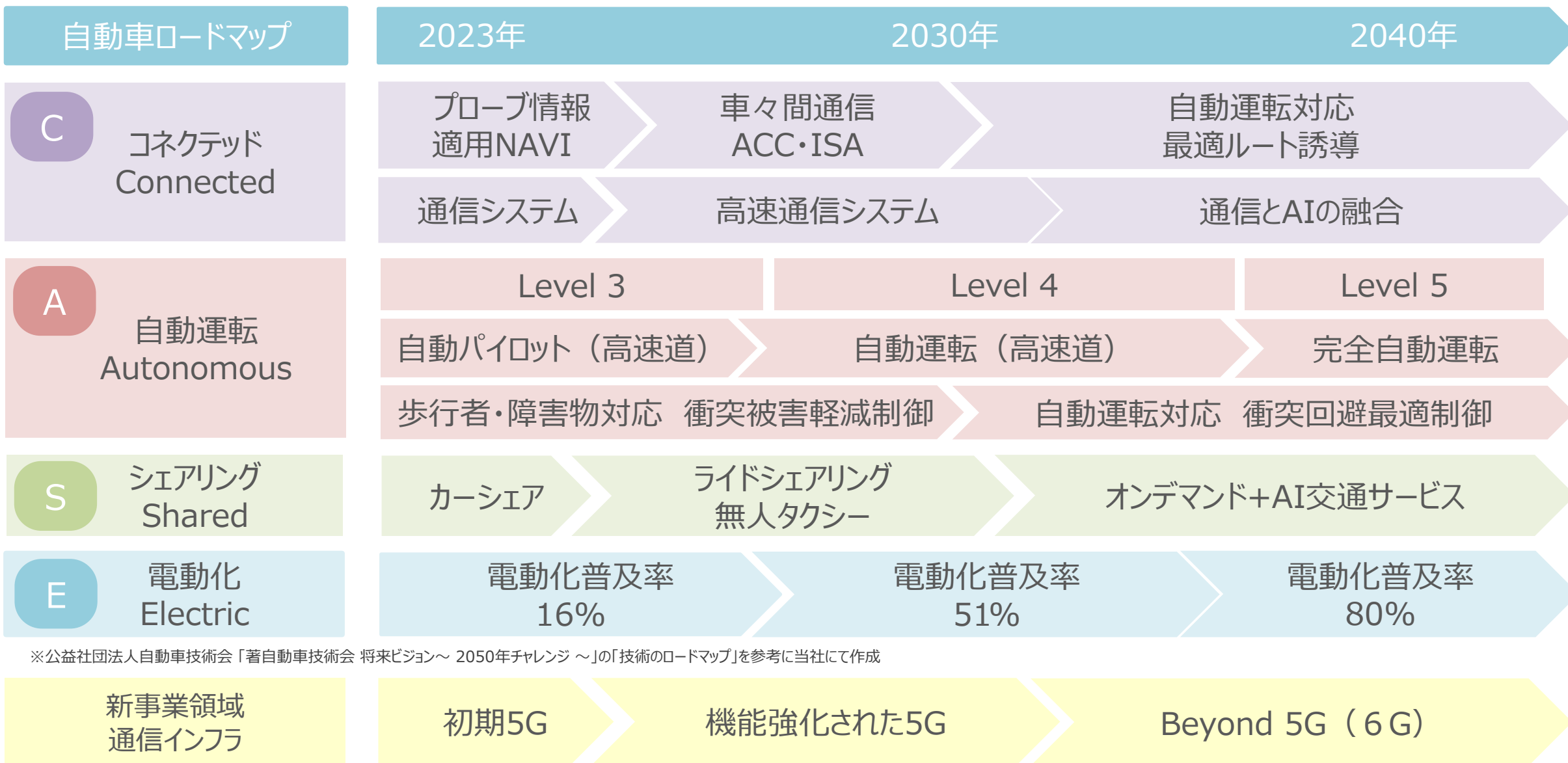
(億円／構成比)	22/3期 実績		27/3期 中計		増減額	増減率
ビルドアップ配線板	210	26%	415	38%	+204	+97%
多層プリント配線板	440	54%	570	52%	+129	+29%
両面プリント配線板	106	13%	60	5%	-46	-43%
その他	56	7%	55	5%	-1	-4%
合計	814	100%	1,100	100%	+285	+35%

④地域別業績



(億円)		22/3期 実績	27/3期 中計	増減額	増減率
日本	売上高	494	650	+155	+32%
	営業利益	22.6	39.0	+16.3	+72%
中国	売上高	299	380	+80	+27%
	営業利益	7.0	19.0	+11.9	+169%
東南アジア	売上高	252	460	+207	+82%
	営業利益	10.7	41.0	+30.2	+281%
欧米	売上高	37	100	+62	+168%
	営業利益	1.4	7.0	+5.5	+390%
消去又は全社	売上高	▲269	▲490	-220	-
	営業利益	▲11.6	▲11.0	+0.6	-
連結	売上高	814	1,100	+285	+35%
	営業利益	30.2	95.0	+64.7	+215%






⑤-1. CASE自動車及び新事業領域のロードマップと対応状況



※公益社団法人自動車技術会「著自動車技術会 将来ビジョン～ 2050年チャレンジ～」の「技術のロードマップ」を参考に当社にて作成

※総務省「Beyond 5G推進戦略 -6Gへのロードマップ-」を参考に当社にて作成

⑤-2. CASE自動車及び新事業領域のロードマップと対応状況

市場の要求	アイテム	基板への要求	当社の技術革新
<p>C  コネクテッド Connected</p>	<p>通信モジュール 5G,V2X エン터테인먼트 IVI</p>	<p>低損失 SoCプロセッサ搭載</p>	<p>低誘電材、特性インピーダンス制御 多段HDI、微細回路 MSAP</p>
<p>A  自動運転 Autonomous</p>	<p>ミリ波レーダー センシングカメラ</p>	<p>アンテナ回路精度安定 小型化、3次元</p>	<p>高精細回路形成 MSAP 多段HDI、高板厚リジッドフレックス</p>
<p>S  シェアリング Shared</p>	<p>車載AI搭載 インフラ向けユニット</p>	<p>AIプロセッサ搭載 高多層、小径VIA</p>	<p>低誘電材、特性インピーダンス制御 多段HDI、高アスペクト</p>
<p>E  電動化 Electric</p>	<p>統合ECU パワーモジュール</p>	<p>制御回路と電源の混在 大電流、高電圧、耐熱</p>	<p>厚銅回路、内層銅コア、高放熱材 高絶縁レジスト、放熱シミュレーション</p>
<p> 新事業領域 通信インフラ</p>	<p>5G高速通信 基地局スモールセル</p>	<p>高多層、低損失 高密度、微細配線</p>	<p>低誘電材、高多層、高アスペクト サブトラ微細配線、バックドリル</p>

⑥. 技術ロードマップ



当社の革新技术

23/3期

24/3期

25/3期

26/3期

27/3期

C



高密度

多段HDI BVHスタック

多段HDI AnyLayer

微細回路 MSAP

量産中

試作

量産

開発

試作

量産

A



高機能

高精細回路 MSAP

高板厚リジッドフレックス

量産中

開発

試作

量産

S



高周波

低損失

特性インピーダンス制御

試作

量産

±10%(実測管理)

±10%(工程保証)

シミュレーション保証

E



高放熱

厚銅 + 信号回路

高熱伝導

開発

試作

量産

試作

量産



高多層

高アスペクト (Aspect Ratio)

サブトラ微細配線

AR12

AR21

AR24

開発

試作

量産

本資料における将来情報は、2023年11月時点での見込であり、
その実現を保証するものではありません。

(金額は切捨て、%は少数第一位を四捨五入にて表示)

END